

2024-2029年中国汽车芯片市场调查分析与发展趋势预测研究报告

报告简介

在现代市场经济活动中，信息已经是一种重要的经济资源，信息资源的优先占有者胜，反之则处于劣势。中国每年有近百万家企业倒闭，对于企业经营而言，因为失误而出局，极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败、他们的经验教训，可能再也没有机会转化为他们下一次的成功了！企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢牢地锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求及前景。

随着汽车芯片行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的汽车芯片企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中道泰和利用多种独创的信息处理技术，对汽车芯片行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告由中道泰和的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、51行业报告网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个汽车芯片行业的市场走向和发展趋势。

本报告专业！权威！报告根据汽车芯片行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国汽车芯片行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国汽车芯片行业将面临的机遇与挑战，对汽车芯片行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是汽车芯片企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值！

报告目录

第一章 汽车芯片行业发展环境分析

1.1 国际环境

1.1.1 全球发展规模

1.1.2 亚太地区发展

1.1.3 欧洲主导市场

1.1.4 美国adas发展

1.2 政策环境

1.2.1 智能制造政策

1.2.2 集成电路政策

1.2.3 半导体产业规划

1.2.4 “互联网+”政策

1.3 经济环境

1.3.1 国民经济运行

1.3.2 工业经济增长

1.3.3 固定资产投资

1.3.4 转型升级形势

1.3.5 宏观经济趋势

1.4 汽车工业

1.4.1 行业发展势头

1.4.2 市场产销规模

1.4.3 外贸市场规模

1.4.4 发展前景展望

1.5 社会环境

1.5.1 互联网加速发展

1.5.2 智能产品的普及

1.5.3 科技人才队伍壮大

第二章 2019-2023年中国汽车芯片行业发展分析

2.1 2019-2023年中国汽车芯片发展总况

2.1.1 行业发展概述

2.1.2 产业发展形势

2.1.3 市场发展规模

2.2 2019-2023年中国汽车芯片市场竞争形势

2.2.1 市场竞争格局

2.2.2 巨头争相进入

2.2.3 半导体抢占主战场

2.3 2019-2023年汽车芯片技术发展进展

2.3.1 技术研发进展

2.3.2 无线芯片技术

2.3.3 技术发展趋势

2.4 中国汽车芯片行业发展困境分析

2.4.1 过度依赖进口

2.4.2 技术研发不足

2.4.3 行业发展瓶颈

2.5 中国汽车芯片市场对策建议分析

2.5.1 行业发展建议

2.5.2 产业突围策略

2.5.3 企业发展策略

第三章 2019-2023年中国汽车芯片行业产业链分析

3.1 2019-2023年中国半导体材料行业运行状况

3.1.1 产业发展特点

3.1.2 行业销售规模

3.1.3 市场格局分析

3.1.4 产业转型升级

3.1.5 行业发展建议

3.1.6 行业发展趋势

3.2 2019-2023年中国芯片设计行业发展分析

3.2.1 产业发展历程

3.2.2 市场发展现状

3.2.3 市场竞争格局

3.2.4 企业专利情况

3.2.5 国内外差距分析

3.3 2019-2023年中国晶圆代工产业发展分析

3.3.1 晶圆加工技术

3.3.2 国外发展模式

3.3.3 国内发展模式

3.3.4 企业竞争现状

3.3.5 市场布局分析

3.3.6 产业面临挑战

3.4 2019-2023年中国芯片封装测试行业发展分析

3.4.1 封装技术介绍

3.4.2 芯片测试原理

3.4.3 主要测试分类

3.4.4 封装市场现状

3.4.5 封测竞争格局

3.4.6 发展面临的问题

3.4.7 技术发展趋势

第四章 2019-2023年中国汽车芯片行业区域发展分析

4.1 长春

4.1.1 产业发展成就

4.1.2 台企投资动态

4.1.3 产业集群发展

4.2 芜湖

4.2.1 产业支撑政策

4.2.2 产业基地概况

4.2.3 企业项目建设

4.2.4 产业发展目标

4.2.5 产业发展规划

4.3 上海

4.3.1 行业发展成就分析

4.3.2 行业发展促进战略

4.3.3 产业发展专项方案

4.3.4 行业发展瓶颈分析

4.4 深圳

4.4.1 产业发展优势

4.4.2 产业发展成就

4.4.3 产业链的市场

4.4.4 产业发展动态

4.5 其他地区

4.5.1 合肥市

4.5.2 十堰市

4.5.3 东莞市

第五章 2019-2023年汽车芯片主要应用市场发展分析

5.1 adas

5.1.1 adas发展地位

5.1.2 市场竞争现状

5.1.3 技术创新核心

5.1.4 芯片技术发展

5.1.5 投资机遇分析

5.1.6 发展趋势分析

5.1.7 未来发展前景

5.2 abs

5.2.1 系统工作原理

5.2.2 系统优劣分析

5.2.3 中国发展进展

5.2.4 系统发展趋势

5.3 车载导航

5.3.1 市场发展现状

5.3.2 企业竞争格局

5.3.3 产品的智能化

5.3.4 发展问题剖析

5.3.5 未来发展方向

5.4 空调系统

5.4.1 市场发展形势

5.4.2 市场规模分析

5.4.3 企业竞争格局

5.4.4 未来发展方向

5.5 自动泊车系统

5.5.1 系统运作原理

5.5.2 关键技术发展

5.5.3 技术推进动态

5.5.4 未来市场前景

第六章 2019-2023年汽车电子市场发展分析

6.1 国际汽车电子市场概况

6.1.1 主要产品综述

6.1.2 行业发展状况

6.1.3 市场规模发展

6.2 中国汽车电子行业发展概述

6.2.1 市场发展特点

6.2.2 产业发展地位

6.2.3 产业发展阶段

6.2.4 发展驱动因素

6.2.5 市场结构分析

6.2.6 引领汽车发展方向

6.3 2019-2023年中国汽车电子市场发展分析

6.3.1 市场规模现状

6.3.2 出口市场状况

6.3.3 市场结构分析

6.3.4 汽车电子渗透率

6.4 2019-2023年汽车电子市场竞争分析

6.4.1 整体竞争态势

6.4.2 市场竞争现状

6.4.3 区域竞争格局

6.4.4 市场竞争格局

6.4.5 重点厂商swot解析

6.4.6 本土企业竞争策略

6.5 汽车电子市场发展存在的问题

6.5.1 市场面临挑战

6.5.2 产业制约因素

6.5.3 创新能力不足

6.6 中国汽车电子市场发展策略及建议

6.6.1 产业链构建策略

6.6.2 产业发展壮大对策

6.6.3 产业专项规划构思

6.6.4 网络营销策略分析

第七章 国外汽车芯片重点企业运营分析

7.1 高通

7.1.1 企业发展概况

7.1.2 经营效益分析

7.1.3 汽车芯片市场布局

7.1.4 恩智浦收购

7.1.5 市场发展规划

7.2 英特尔

7.2.1 企业发展概况

7.2.2 经营效益分析

7.2.3 新品研发进展

7.2.4 未来发展前景

7.3 英飞凌

7.3.1 企业发展概况

7.3.2 经营效益分析

7.3.3 汽车芯片业务

7.3.4 未来发展前景

7.4 意法半导体

7.4.1 企业发展概况

7.4.2 经营效益分析

7.4.3 产品研发进展

7.4.4 汽车半导体业务

7.4.5 未来发展前景

7.5 瑞萨科技

7.5.1 企业发展概况

7.5.2 经营效益分析

7.5.3 企业并购动态

7.5.4 企业合作动态

7.5.5 未来发展前景

7.6 博世

7.6.1 企业发展概况

7.6.2 经营效益分析

7.6.3 重点布局领域

7.6.4 未来发展前景

7.7 德州仪器

7.7.1 企业发展概况

7.7.2 经营效益分析

7.7.3 产品研发动态

7.7.4 助力互联网汽车

7.7.5 企业合作动态

7.8 索尼

7.8.1 企业发展概况

7.8.2 经营效益分析

7.8.3 销售市场形势

7.8.4 车用芯片业务

7.8.5 企业并购动态

第八章 中国汽车芯片重点企业运营分析

8.1 比亚迪股份有限公司

8.1.1 企业发展概况

8.1.2 经营效益分析

8.1.3 力推芯片国产化

8.1.4 未来发展前景

8.2 中芯国际集成电路制造有限公司

8.2.1 企业发展概况

8.2.2 经营效益分析

8.2.3 车用晶片业务

8.2.4 未来发展策略

8.3 大唐电信科技股份有限公司

8.3.1 企业发展概况

8.3.2 经营效益分析

8.3.3 业务经营分析

8.3.4 汽车芯片业务

8.3.5 财务状况分析

8.3.6 未来前景展望

8.4 上海先进半导体制造股份有限公司

8.4.1 企业发展概况

8.4.2 经营效益分析

8.4.3 业务经营分析

8.4.4 企业合作动态

8.4.5 财务状况分析

8.4.6 未来前景展望

8.5 珠海全志科技股份有限公司

8.5.1 企业发展概况

8.5.2 经营效益分析

8.5.3 业务经营分析

8.5.4 汽车芯片业务

8.5.5 财务状况分析

8.5.6 未来前景展望

第九章 中国汽车芯片行业投资机遇分析

9.1 投资机遇分析

9.1.1 产业爆发增长

9.1.2 巨头加速布局

9.1.3 智能汽车发展加速

9.2 产业并购动态

9.2.1 高通

9.2.2 三星

9.2.3 瑞萨电子

9.3 并购加速动因

9.3.1 汽车数字化推进

9.3.2 半导体行业助力

9.3.3 汽车数字商机爆发

9.3.4 车用晶圆技术发展

9.4 投资风险分析

9.4.1 宏观经济风险

9.4.2 环保相关风险

9.4.3 产业结构性风险

9.5 融资策略分析

9.5.1 项目包装融资

9.5.2 高新技术融资

9.5.3 bot项目融资

9.5.4 ifc国际融资

9.5.5 专项资金融资

第十章 中国汽车芯片产业未来发展前景展望

10.1 中国汽车电子市场前景展望

10.1.1 全球市场机遇

10.1.2 市场需求分析

10.1.3 十四五发展趋势

10.1.4 产品发展方向

10.2 中国汽车芯片产业未来前景预测

10.2.1 未来发展规模

10.2.2 市场规模预测

10.2.3 芯片需求市场

图表目录

图表：亚太各地区晶片销售金额与全球占比(依应用别区分)

图表：2024-2029年美国adas市场规模及预期

图表：2019-2023年美国汽车市场adas功能使用现状

图表：2024-2029年美国汽车市场防碰撞预警功能安装趋势

图表：智能制造系统架构

图表：智能制造系统层级

图表：mes制造执行与反馈流程

图表：云平台体系架构

图表：2019-2023年中国汽车销量月度增长走势

图表：2019-2023年中国乘用车销量月度增长走势

图表：2019-2023年中国商用车销量月度增长走势

图表：2019-2023年中国1.6升及以下乘用车销量月度走势

图表：2019-2023年中国乘用车市场各系别市场份额情况

图表：2019-2023年中国主要车企汽车销售市场占有率

图表：2019-2023年中国汽车销量月度增长走势

图表：2019-2023年中国乘用车销量月度增长走势

图表：2019-2023年中国商用车销量月度增长走势

图表：2019-2023年汽车商品月度进口金额及同比增长变化情况

图表：2019-2023年七大类汽车商品进口金额所占比重

图表：2019-2023年汽车商品进口金额及同比增长变化情况

图表：2019-2023年月度汽车进口量及同比增长变化情况

图表：2019-2023年整车主要品种进口量构成

图表：2019-2023年乘用车三大类品种分排量进口情况

图表：2019-2023年汽车整车进口量及同比增长变化情况

图表：2019-2023年汽车零部件进口金额及同比增长变化情况

图表：2019-2023年前十名进口来源国进口金额所占比重

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

本文地址 : <https://www.51baogao.cn/sc/20191203/149313.shtml>

在线订购 : [点击这里](#)